

高熱伝導PCの代表的な成形条件

▶ 熱伝導PCは、グレード別に推奨する成形条件が異なります

	TPN1125, TPN1124	TPN1122, TCF140 TPN1022	TPN2131, TPN2140 TPN2354, TPN2560
予備乾燥	120 °C, 4 ~ 6 時間	100 °C, 4 ~ 8 時間	100 °C, 4 ~ 8 時間
シリンダー温度	300 ~ 320 °C	280 ~ 300 °C	260 ~ 280 °C
ノズル温度	310 ~ 330 °C	290 ~ 310 °C	280 ~ 290 °C
金型温度	100 ~ 120 °C	70 ~ 100 °C	50 ~ 90 °C
射出圧力	50 ~ 150 MPa	50 ~ 150 MPa	50 ~ 150 MPa
スクリー回転数	50 ~ 150 rpm	50 ~ 150 rpm	50 ~ 150 rpm

▶ 熱伝導PCの射出成形では、一般に次のような成形条件にすると、良品が得られやすくなります

■ 金型温度 **高温** ■ 射出速度 **高速** ■ 射出圧力 **高圧**

Copyright, Mitsubishi Engineering-Plastics Corp., All rights reserved.

